

株主通信

2023年12月期決算のご報告
(2023年1月1日～2023年12月31日)

株式会社 **日本マイクロニクス**

証券コード：6871

To Our Shareholders ▶ 株主・投資家の皆さまへ

株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

はじめに、このたびの能登半島地震で亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆さまにお見舞いを申し上げます。被災地域の1日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

市場について

第53期（2023年1月1日から12月31日）連結会計年度の事業環境は、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化や、新たにイスラエル・ハマス紛争が勃発するなど、地政学的なリスクが高まりました。このような不確実性が高まるなか、物価上昇圧力は依然として強く、これを抑制するために米欧を中心に政策金利が高止まりし、経済活動に影響を与えました。当社が軸足を置く半導体業界におきましては、民生用電子機器の需要減少やデータセンター投資の減速により、半導体メーカーの在庫調整や設備投資の先送りに繋がりました。さらに、車載用のアナログ半導体やマイコン、産業機器向け半導体市場も減速傾向となり、半導体市場全体では4年ぶりのマイナス成長となる見込みです。一方、生成AIの普及が加速するなか、AIサーバーの出荷台数は前年同期比で増加し、それに伴いHBM（高性能メモリ）の需要が拡大しました。

また、FPD市場においては、テレビ・パソコンともに需要が落ち込み、液晶パネルの需要回復には時間がかかる見込みです。

業績について

半導体市場の減速の影響を受け、当社グループの上期業績は厳しい状況となりました。一方、下期にかけては、HBMの需要拡大によるDRAMメモリ向けプローブカードが好調となり、業績が大きく回復しました。

こうしたなか、当社グループは2026年度を最終年度とする中期経営計画「FV26」を策定し、経営指標および重点施策を公表いたしました。当期においては設備投資、研究開発投資をはじめ「FV26」の施策を推進してまいりました。

この結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高38,292百万円（前年同期比13.6%減）、営業利益5,312百万円（前年同期比42.4%減）、経常利益5,675百万円（前年同期比45.6%減）、親会社株主に帰属する当期純利益4,127百万円（前年同期比45.2%減）となりました。

引き続き「FV26」の諸施策を着実に推進し、計画達成に向けた取り組みを進めてまいります。

株主の皆さまにおかれましては、なお一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 

中期経営計画『FV26』の進捗と新たな成長機会

研究開発への取り組み

TE事業の新製品リリース

TE事業では2023年9月15日に新テストをリリースいたしました。

リリースに先立ち、2023年9月6日～8日に開催されたSEMICON Taiwan 2023に出展し、大きな反響をいただきました。半導体検査の現場では、テストの最適化とコストの低減が求められており、本テストはお客さまごとに専用のテスト環境を構築することで、課題解決をサポートします。

また、テストに続きマニュアルタイプのプローバを12月に開催された「SEMICON Japan 2023」で紹介しました。

FV26の計画達成に向けたTE事業の主要な施策として、これら新製品の拡販に取り組みます。



テスト

プローバ

設備投資の進捗アップデート

青森工場の新棟建設

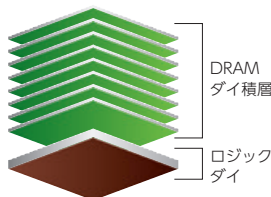
当社の中期経営計画FV26ではプローブカードの生産能力強化を成長への取り組みの一環としています。具体的には青森工場の新棟建設と韓国現地法人MEK Co., Ltd.の新工場建設であることは、すでにお知らせしたとおりです。

MEKについては、すでに稼働を開始しています。一方、青森工場新棟については基礎工事を終え、建屋の建設を開始しています。建設は順調に進行しており、計画どおり2024年12月の竣工を予定しています。



HBMの市場拡大による新たな成長機会

生成AIの普及により、AIサーバーやHPC（ハイパフォーマンスコンピューティング）などの高性能なアプリケーションが急増しています。これらに使用されるGPUの需要の増加に伴い、GPUの性能を引き出すためにHBMの需要も同時に高まっています。HBMはDRAMを積層していることから、DRAM市場でシェアの大きい当社が注目されています。



HBM積層イメージ

HBMとは？

HBM : High Bandwidth Memory
広帯域かつ消費電力効率の高いDRAMの一種です。DRAMチップを積層することで、高速で大容量のデータ転送を実現します。主にGPU/CPUとパッケージングされ、AIサーバーなどに搭載されます。

HBMの特徴

- 高機能化に伴いテストが長時間化し、プローブカードの需要が増加。
- 通常のDRAMと比較してプロセスが複雑で、各工程での不良発見がコストに直結。プローブ検査もプロセスごとに実施。
- さらなる高集積化・高速化・大電力化により高性能なプローブカード開発への期待。

新たな成長機会

当社の強み

- 先進的な技術に追随したメモリプローブカードの技術開発を常にリード。
- HBM向けのテストに対応した技術力。
- HBMの需要拡大に対するタイムリーな供給能力。
- DRAM向けプローブカードにおける当社の実績と信頼性。

中期経営計画『FV26』のもと、
幅広い市場ニーズに対応する
多角的な製品ポートフォリオを構築し、
持続的成長と企業価値の最大化を
めざしてまいります



Q 第53期(2023年12月期)の事業環境とMJCの取り組みを総括してください。

A 当期の半導体市場は前期から一転、期初より受注が落ち込み厳しい状況となりましたが下期にかけ生成AI向けの需要が拡大し、当社グループにおいてもメモリ向けプローブカードの受注が大幅に増加しました。上期の需要停滞とノンメモリ向け製品の不振が重なったことで、当期の連結業績は減収減益となりましたが、生成AI市場の活性化は2024年の市場回復を期待させる明るい材料と言えるでしょう。

こうした状況のなか、当社グループは事業推進体制のさらなる高度化に向けて多彩な取り組みを実行しました。2023年7月に青森工場新棟の建設に着手したの続き、9月には韓国現地法人の新工場が稼働を開始し、プローブカードの生産能力の拡充に向けた準備を進めております。青森工場は2024年12月の竣工を予定しており、稼働開始の暁には、市場ニーズの拡大に即応できる機動的な供給体制が完成することになります。

当期は新製品の開発と市場投入にも注力しました。な

かでも2023年9月に販売を開始した垂直型MEMSプローブカード「MEMS-V」は、中期経営計画におけるノンメモリプローブカード事業の中核製品として、当社の収益拡大に寄与するものと考えています。

Q 中期経営計画『FV26』の策定の狙いと製品別の戦略をご説明ください。

A 第56期(2026年12月期)を最終年度とする新たな中期経営計画『FV26』がスタートしました。「FV26」では、実効性ある設備投資および研究開発投資を実施することにより、市場成長率を上回る成長を目指しています。半導体メーカーの設備投資が活発化するなか、急増するプローブカード需要の確かな取り込みが求められていることから、青森工場新棟をはじめ、積極的な整備投資を通じてより安定的な生産体制を確立していきます。2023年～2026年の4年間の設備投資は300億円、研究開発投資は200億円、最終年度の経営指標は売上高650億円、営業利益150億円に設定しました。

製品戦略については、ノンメモリのロジック向け製品においてもMJCの存在感を発揮していきたいと考えています。現在、当社の売上高はその8割近くをメモリ向けが占めています。当社グループがさらなる成長を実現するためには、メモリ向けの業容を維持した上で、ノンメモリの売上拡大を図り、製品ポートフォリオの適正化・多角化を図ることが欠かせません。「MEMS-V」に加え、新型テストや新型プローバの開発と拡販を加速することで、お客さまの多様なニーズに対応する総合的なラインナップを構築したいと考えています。

Q 持続的な成長に向けた基盤づくりについては、どのような取り組みを進めていますか。

A 経営と事業の基盤強化に向けては現在、サステナビリティへの取り組み、DXの推進、そして人的資本強化の3テーマについて全社的な取り組みを展開しています。

プライム企業としての責務であるサステナビリティへの取り組みについては、2023年3月に新設したサステナビリティ推進室を中核組織として、生産活動における環境負荷の低減をはじめ、地球環境と経済社会の持続可能性に寄与するための諸施策を推進しています。

DXはデジタル技術を駆使して新たな価値を創造していくための戦略的な取り組みです。各種業務の電子化、システム化や生産プロセスの自動化を通じて、当社の存在価値をさらに高めてまいります。

当社グループの最大の資産である人材に関しては、従来どおり、充実した教育研修システムを通じて人材育成を図ります。同時に、多様性を尊重する組織風土の醸成や社員の自己実現のサポートなど、人的基盤を強化するため重層的な取り組みを進めていきます。

Q 最後に第54期(2024年12月期)の経営方針を教えてください。

A 第54期は「FV26」のもとで次の成長に挑戦する「新たな第一歩」の年度となります。半導体市場は、生成AIの普及に伴うHBMの需要拡大など、市況回復に向けた動きも本格化する見通しです。当社グループにおいては生産体制、販売、人材育成の各領域において将来への布石を打ち、事業基盤の一層の強化を図っていきます。また先般の能登半島地震を教訓に、生産現場における安全管理を徹底することも、BCP(事業継続計画)の観点から不可欠の経営テーマだと捉えています。

製品戦略については、「MEMS-V」など、今後の収益の一角を担うノンメモリ向け製品の市場浸透に努めていきます。さらに、2024年に設立予定のミュンヘン事務所を拠点に、ヨーロッパ市場の開拓・深耕にも注力していく計画です。

株主の皆さまへの利益還元に関しては、引き続き、安定的な配当と将来投資による継続的な利益成長により、日頃のご支援にお応えしていきたいと考えています。第53期の期末配当は、業績や内部留保の充実などを勘案し、1株当たり33円とさせていただきます。

当社グループはメモリ向けプローブカードのトップサプライヤーとして高い知名度を誇っていますが、昨年来、生成AI関連銘柄として注目されたことにより、半導体検査分野で幅広い製品・サービスを提供する企業であることが広く認知されるようになってきました。これまで進めてきた選択と集中の取り組みが、業界や資本市場からの再評価に結実していることを実感しています。今後もQDCCSSの精神を堅持しつつ、中長期的な成長と企業価値の最大化を追求していきます。

株主の皆さまには、引き続き当社に対するご理解とご支援を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

Topics 01

SEMICON Japan 2023に出展しました

2023年12月13日～15日に東京ビッグサイトで開催されたSEMICON Japan 2023に出展いたしました。本展示会は、国内外1,000社以上の半導体関連企業が参画する国内最大規模の業界イベントです。今回は開催規模が拡大されたこともあり、前年比65%増の85,000人が来場し、大盛況でした。会場内では空飛ぶクルマや4足歩行ロボットなどの最新鋭アプリケーションの展示が注目を集めていました。当社は新製品MEMS-V・カスタムテストの実機、プローバのパネルを目玉に展示いたしました。また高専生の研究発表に協賛し、半導体製造装置業界の未来を担う人材と交流を深めました。今後も新規パートナーの獲得やプレゼンス向上を目指すとともに、業界全体の発展にも尽力していきます。



Topics 02

SEMICON Taiwan 2023に出展しました

2023年9月6日～9月8日に台湾で開催されたSEMICON Taiwan 2023に台湾現地法人Taiwan MJC Co., Ltd.が出展しました。SEMICON Taiwanは台湾最大規模の半導体製造装置・材料の総合展示会です。最先端の半導体を製造している台湾は、世界中から注目されており、展示会には過去最多の950社が出展し、日本企業も多く出展していました。

MJCブースでは、2023年9月に販売を開始したMEMS-Vを初めて展示しました。今後も、ビジネス拡大に向けたPR活動を展開していきます。



Topics 03

機関投資家・アナリスト向け工場見学会を開催

2023年10月、青森県平川市の青森工場において、4年ぶりとなる工場見学会を開催しました。当社プローブカード事業、およびTE事業の基本的な事業内容、新中期経営計画FV26における成長戦略の説明後、見学通路から製造現場を見学していただきました。また、見学会当時はまだ基礎工事中でしたが、既存工場と比較した新棟の規模をご覧いただきました。質疑応答も交えながら活発な意見交換を通じて、参加者の方々からは「事業や製品に関する理解が深まった」との声をいただきました。今後も当社事業をご理解いただくための活動を積極的に実施してまいります。



Topics 04

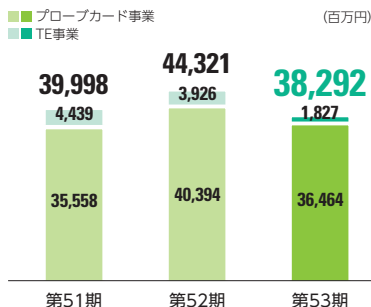
サステナビリティへの取り組み

当社グループではサステナビリティの推進を中期経営計画FV26の重点施策と位置付けています。サステナビリティ推進室を中心に、多くの課題の中から当社グループのマテリアリティ（重要課題）を特定し、各担当部門と連携しながら取り組みを進めてまいります。また、具体的な取り組み内容に関しましては、当社ホームページや株主通信にて情報を発信していきます。

Financial Highlight ▶ 財務ハイライト<通期>

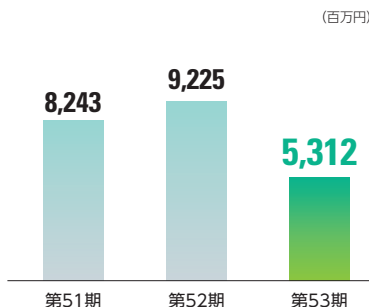
売上高

38,292 百万円
前年同期比 **13.6%** 減



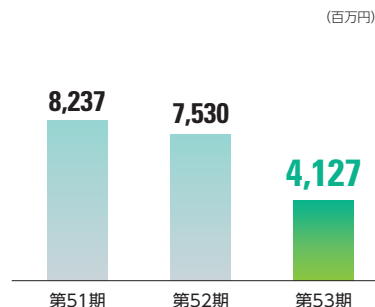
営業利益

5,312 百万円
前年同期比 **42.4%** 減



親会社株主に帰属する 当期純利益

4,127 百万円
前年同期比 **45.2%** 減



※各期の実績は、百万円以下切り捨てで表記しております。

Earnings Forecast ▶ 業績予想 (2024年2月14日現在)

	第54期 第2四半期累計予想
売上高	24,400 百万円
営業利益	4,500 百万円
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,300 百万円

About Stocks ▶ 株式事務についてのご案内

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
 連絡先 東京都府中市日鋼町1-1
 電話0120-232-711 (通話料無料)
 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

株式会社 **日本マイクロニクス**
 〒180-8508 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-6-8
<https://www.mjc.co.jp/>

